【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成19年3月1日(2007.3.1)

【公開番号】特開2006-51772(P2006-51772A)
【公開日】平成18年2月23日(2006.2.23)
【年通号数】公開・登録公報2006-008
【出願番号】特願2004-236607(P2004-236607)
【国際特許分類】
Ｂ４１Ｊ　2/05　(2006.01)
Ｂ４１Ｊ　2/16　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ４１Ｊ　3/04　１０３Ｂ
Ｂ４１Ｊ　3/04　１０３Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成19年1月17日(2007.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
通電に応じてインクを吐出するために利用される熱エネルギを発生する発熱部を有するインクジェットヘッド用基板であって、
前記発熱部を形成するための間隙を有する電極配線層と、
前記間隙を含め前記電極配線層の上層として配置される発熱抵抗体層と、
前記電極配線層および前記発熱抵抗体層の上層として配置され、前記発熱部上で前記間隙より広い間隙を有する第１保護層と、
該第１保護層が有する間隙を含め前記第１保護層の上層として配置される第２保護層と、
を具えたことを特徴とするインクジェットヘッド用基板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
通電に応じてインクを吐出するために利用される熱エネルギを発生する発熱部を有するインクジェットヘッド用基板の製造方法であって、
基体上に、前記発熱部を形成するための間隙を有する電極配線層を配置する工程と、
前記間隙を含め前記電極配線層の上層として発熱抵抗体層を配置する工程と、
前記電極配線層および前記発熱抵抗体層の上層として第１保護層を配置する工程と、
該第１保護層を前記発熱部上で前記間隙より広い間隙を有する範囲で除去する除去工程と、
前記範囲を含め前記第１保護層の上層として第２保護層を配置する工程と、
を具えたことを特徴とするインクジェットヘッド用基板の製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１０

【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１０】
前記発熱抵抗体層を配置する工程後に、前記第１保護層を配置する工程を含め前記基体が４００℃以上にさらされる工程が存在することを特徴とする請求項７ないし請求項９のいずれかに記載のインクジェット記録ヘッド用基板の製造方法。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１１】
前記除去工程後に、前記第２保護層が配置されるに先立って、前記第１保護層の上層として配置されるとともに前記電極配線層と電気的に接続される第２電極配線層を配置する工程をさらに具えたことを特徴とする請求項７ないし請求項１０のいずれかに記載のインクジェット記録ヘッド用基板の製造方法。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
そのために、本発明は、通電に応じてインクを吐出するために利用される熱エネルギを発生する発熱部を有するインクジェットヘッド用基板であって、
前記発熱部を形成するための間隙を有する電極配線層と、
前記間隙を含め前記電極配線層の上層として配置される発熱抵抗体層と、
前記電極配線層および前記発熱抵抗体層の上層として配置され、前記発熱部上で前記間隙より広い間隙を有する第１保護層と、
該第１保護層が有する間隙を含め前記第１保護層の上層として配置される第２保護層と、
を具えたことを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
また、本発明は、通電に応じてインクを吐出するために利用される熱エネルギを発生する発熱部を有するインクジェットヘッド用基板の製造方法であって、
基体上に、前記発熱部を形成するための間隙を有する電極配線層を配置する工程と、
前記間隙を含め前記電極配線層の上層として発熱抵抗体層を配置する工程と、
前記電極配線層および前記発熱抵抗体層の上層として第１保護層を配置する工程と、
該第１保護層を前記発熱部上で前記間隙より広い間隙を有する範囲で除去する除去工程と、
前記範囲を含め前記第１保護層の上層として第２保護層を配置する工程と、
を具えたことを特徴とする。